

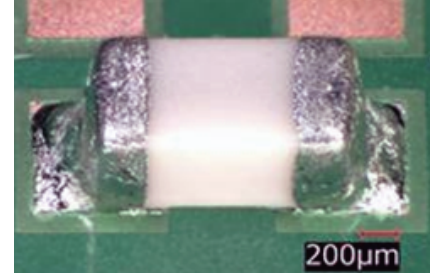
### レーザーで、部分はんた付け可能な M705-SGC007

M705-SGC007 Solder Paste at Laser Selective Soldering

#### 特長

- 印刷用メタルマスクを使わず非接触で高速供給が可能
- 実装後の基板に部分供給できレーザーで部分加熱が可能
- 印刷できない3D基板へのソルダペースト供給が可能
- はんだ量の不足が予測されるランドへのはんだの追加供給が可能

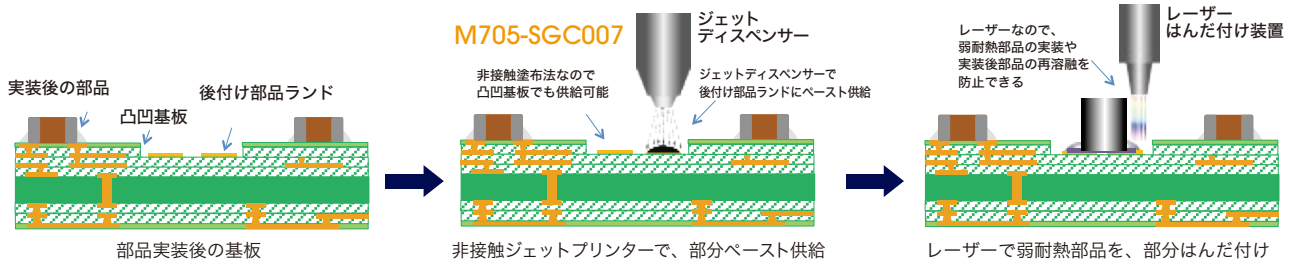
レーザーはんた付け部品



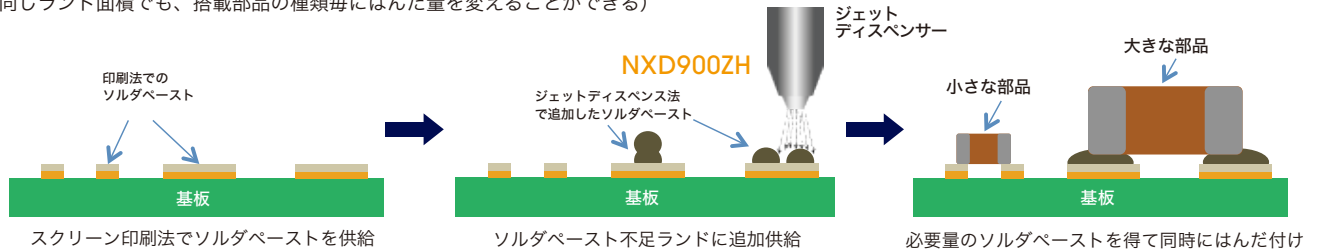
#### Revolutionary Products

### ジェットディスペンス工法によるレーザーはんた付け

マスクフリーなので凹み部への部品の後付が可能で、再溶融を防止できるレーザーでの部分はんた付けにも対応



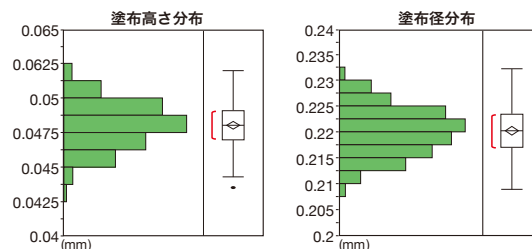
はんだ量の不足が予測されるランドにソルダペーストの追加供給が可能 (同じランド面積でも、搭載部品の種類毎にはんだ量を変えることができる)



- 精度の高いDot塗布とLine塗布を実現



- 25000ショット後も良好な塗布性能を示す



- 1Weekの冷蔵保管後でも良好な塗布

